

# LPBフォーマットとTSV/3次元実装に対応した CR-8000による最先端テクノロジーへの追究と、 検証・評価期間短縮への試み

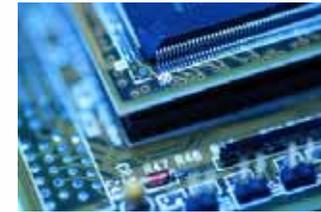
# 1. ものづくり企業をとりまく課題

高付加価値型の商品開発やものづくりにおける技術革新を行うことが、海外勢に対して競争優位を築く活路

## 高付加価値型の商品開発に必要な3つのキーワード

テクノロジー

コア技術による競争力強化



コンカレント

開発スピードの競争力強化



グローバル

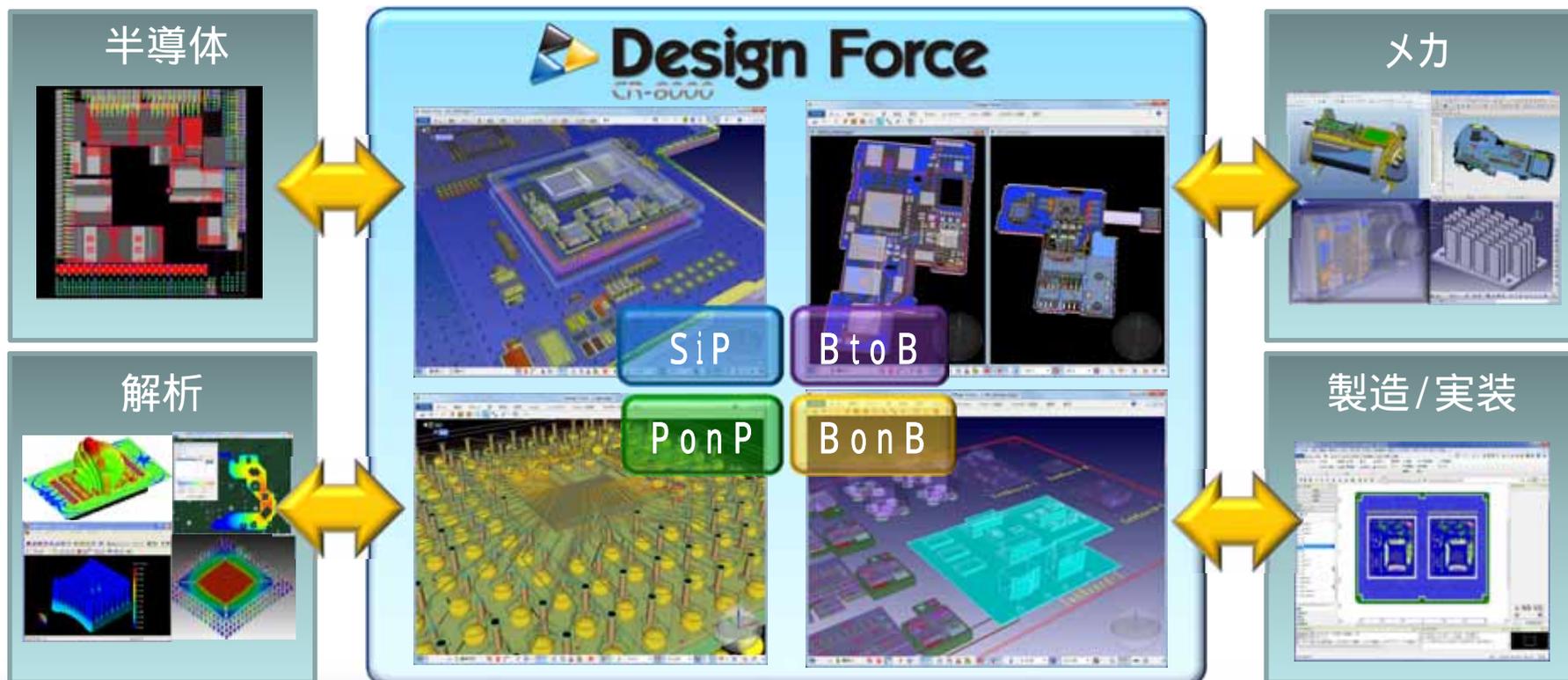
世界市場での競争力強化



## 2. コア技術による競争力強化

### システムレベルデザインの実現

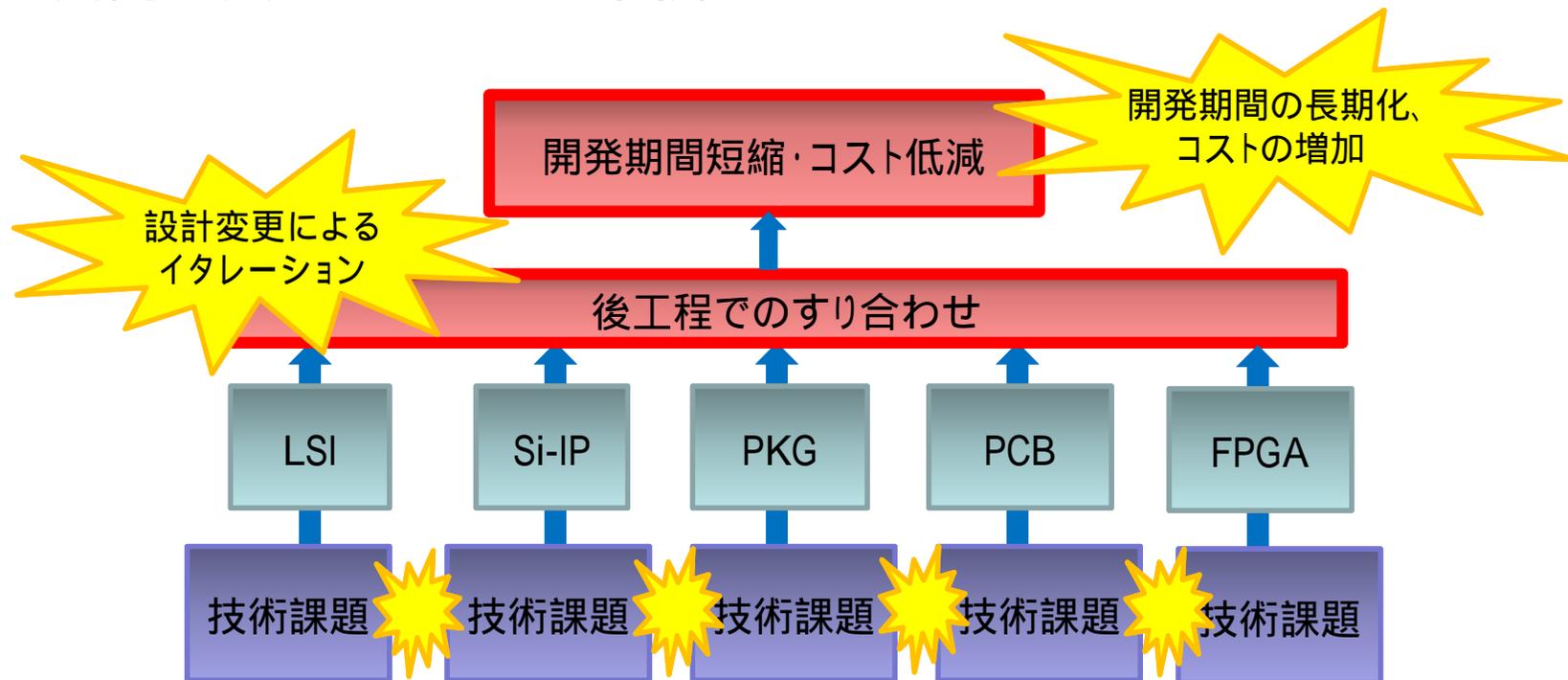
- 基板単体ではなく、システムを設計するためのCADの実現
- LSI/PKG/PCB/メカの垣根を越えたシステムレベルデザインを可能にする統合型設計検証環境



### 3. 開発スピードの競争力強化

#### LSI/PKG/PCB全体協調設計

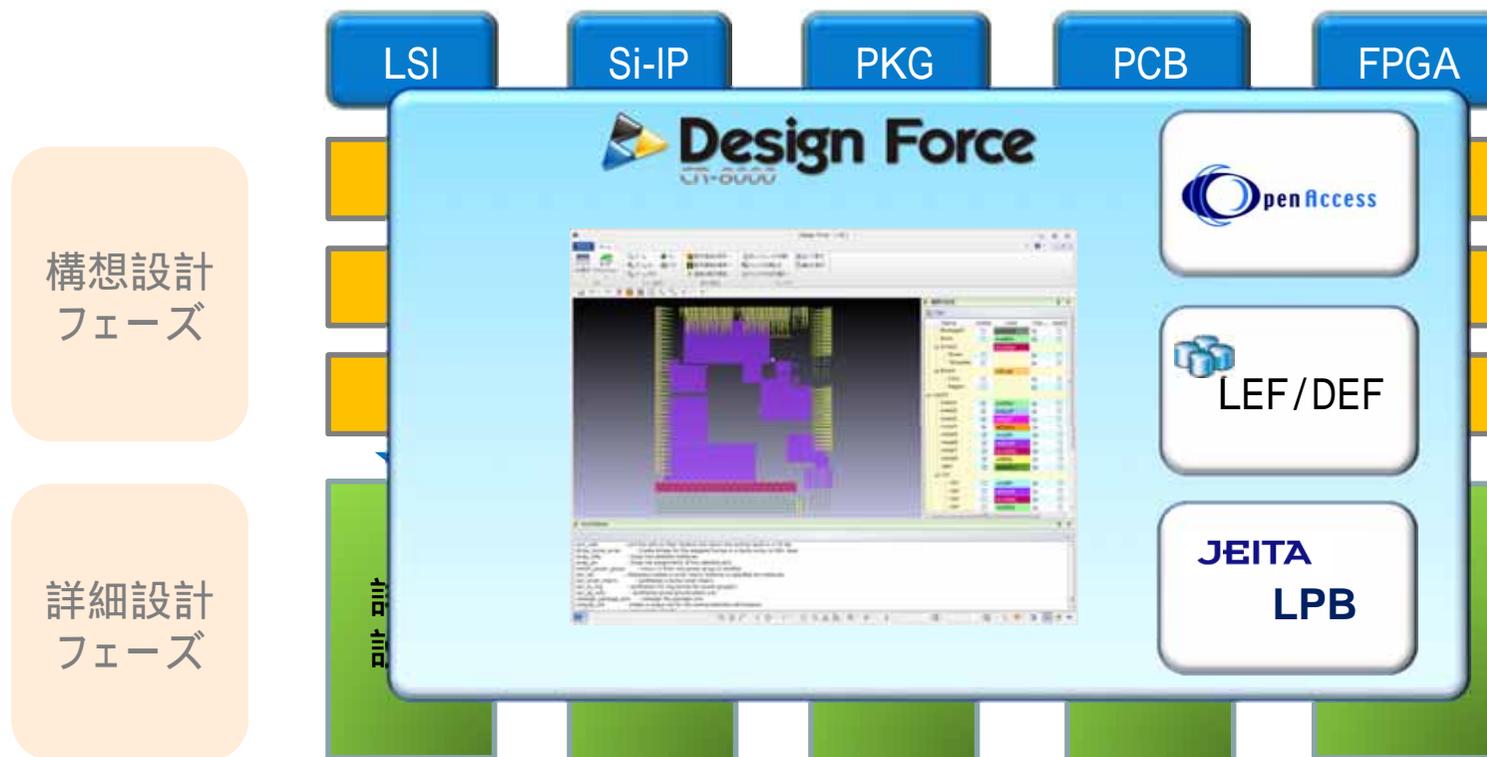
- 従来のLSI、PKG、PCBの単体個別開発では高度/複雑化する設計課題に対してシステム/モジュールとして高い完成度を短期間で実現することは困難



### 3. 開発スピードの競争力強化

#### LSI/PKG/PCB全体協調設計

- 各設計部門の垣根を越えて協調するために互いに連携して課題解決に取り組む仕組みの実現が必要不可欠



### 3. 開発スピードの競争力強化

## LSI/PKG/PCB全体協調設計



**Design Force**  
CR-6000

半導体  
パッケージ  
プリント基板

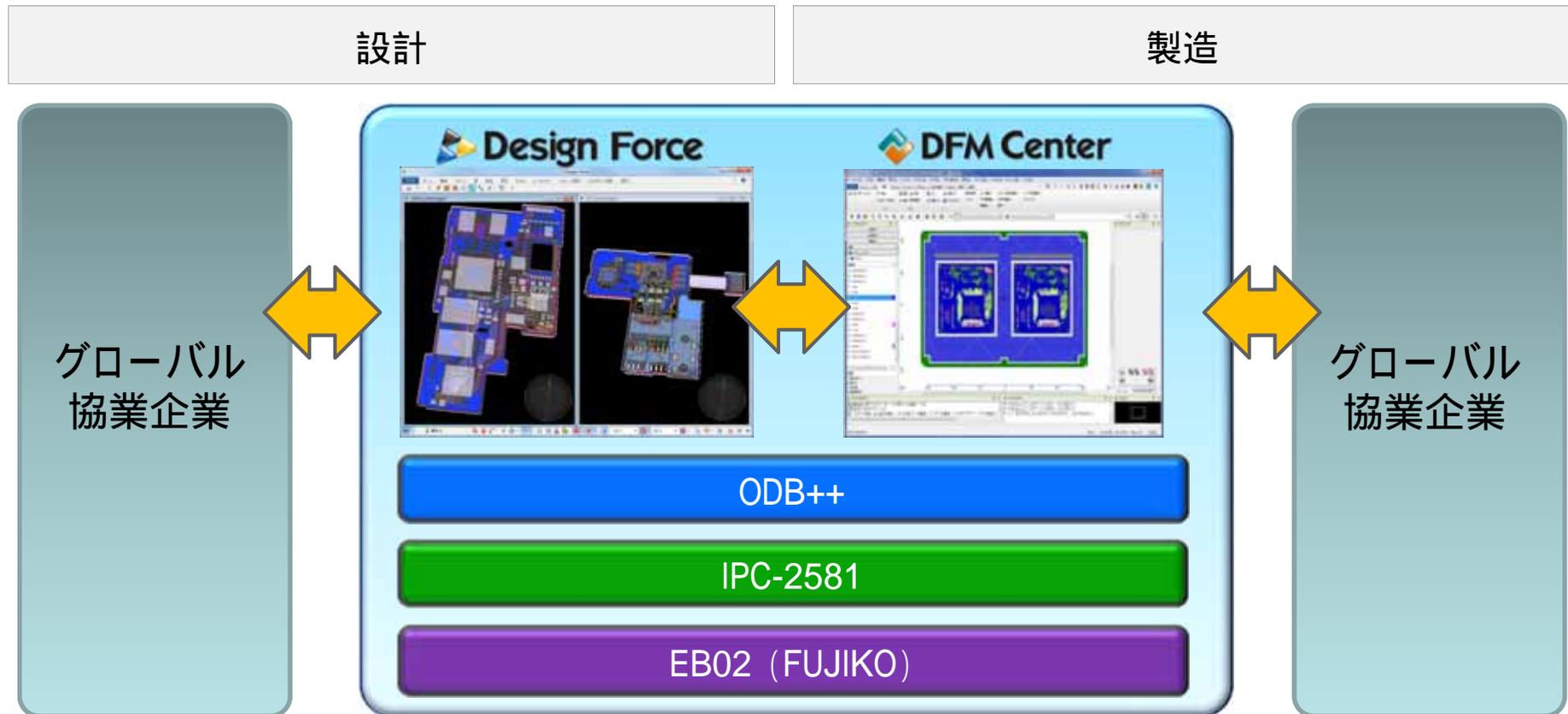
- LPB C, G Formatに対応
- SoC/PKG協調設計
- 混在テクノロジーによるマルチオブジェクト階層設計
- 3次元実装による大規模複合デバイス設計
- あらゆる設計プロセスに対応
- システム視点での信号のトレーサビリティ

	LSI設計	PKG設計	Board設計
構想設計	材料・製造ルール選択		
	ラフ設計	ラフ設計	ラフ設計
	セットアップ・モデル化		
	Sim		
	DR(分析・フィードバック)		
詳細設計	パターン設計	パターン設計	パターン設計
	セットアップ・モデル化		
	Sim		
	DR(分析・フィードバック)		

## 4. 世界市場での競争力強化

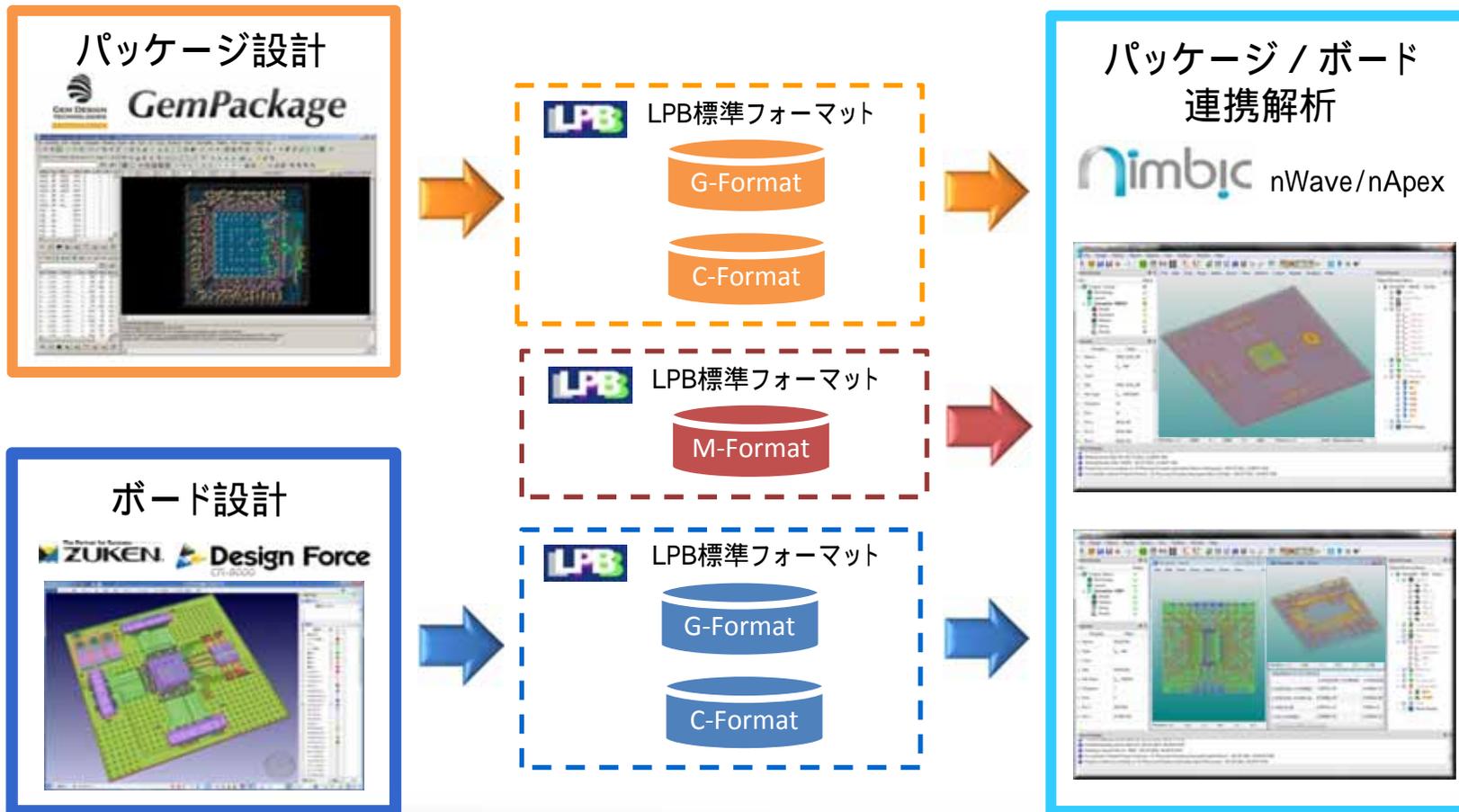
### 設計/製造データのグローバル対応

- 世界市場における汎用的データフォーマット入出力に対応し  
設計～製造までデータ流通制約のない協業を実現



# JEITA LPB相互設計ワーキンググループ

## ● LPB標準フォーマット運用例



LPBフォーマットとTSV/3次元実装に対応した  
CR-8000による最先端テクノロジーへの追究と、  
検証・評価期間短縮への試み

ご清聴ありがとうございました